

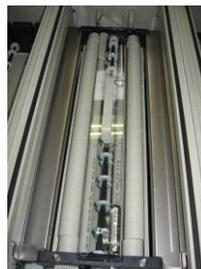


## HEIßLUFT-VERZINNUNGS-ANLAGE

Erhältlich Typen:: 18"x18" bis zu 30"x30"  
 SPS gesteuerte oder elektrisch gesteuerte Ausführung  
 Für Blei Zinn oder Bleifreie Anwendung.

## HCL ANLAGEN / SPEZIALPRODUKTE

Polypropylen-Linien oder Anwendungen:  
 Spülen / Trocknen, Vor- und Nachreinigung, Fluxgeräte,  
 Dosiereinheiten, Misch- und Puffertanks, Kundenspezifisch,  
 Prototyp und Spezial  
 Anwendungen.



## VERTIKALE PLATING LINIEN (VPL)

Automatische Leiterplattenanlagen  
 für die Oberflächenbehandlungs-  
 verfahren für Kupfer Leiterplatten-  
 aufbau, ENIG, ENEPIG Linien usw.  
 Oberflächenbehandlungslinien für  
 Forschung, Entwicklung und  
 manuelle Fertigung.

**New Technology Overman** hat sich spezialisiert auf Design, Entwicklung, Herstellung und liefern von komplette Hot Air Solder Levellers , HASL Prozesslinien , galvanotechnischen Anlagenbau von Leiterplattenanlagen in Gestell- oder Korbtechnik für die Oberflächenbehandlungsverfahren in der gedruckten Leiterplatten Industrie.